

第38回 ネプコン ジャパン 出展のお知らせ

日本シイエムケイでは、**新たなモビリティ社会のニーズ**に応える**車載信頼性をベースとしたプリント配線板技術**を多数ご紹介いたします。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

会 期： 2024年1月24日(水)～26日(金)

会 場： 東京ビッグサイト 東展示棟(東3ホール)

小間番号： E24-38

